

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日

2014 年 11 月 27 日(27.11.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/188824 A1

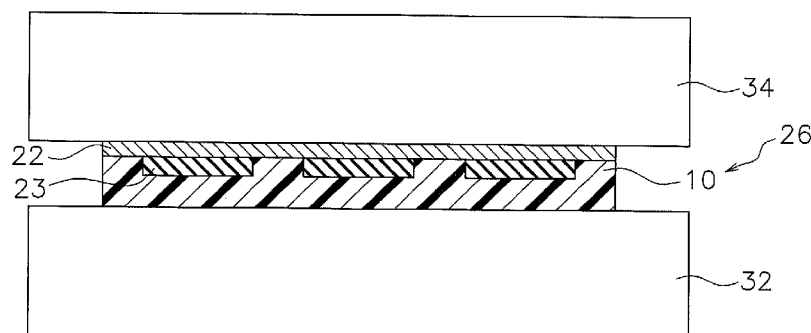
- (51) 国際特許分類:
H01L 21/56 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
H01L 23/29 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/060796
- (22) 国際出願日: 2014 年 4 月 16 日(16.04.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-108840 2013 年 5 月 23 日(23.05.2013) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 千歳 裕之(SENZAI, Hiroyuki); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 松村 健(MATSUMURA, Takeshi); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 豊田 英志(Toyoda, Eiji); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 飯野 智絵(IINO, Chie); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒
- 5320111 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3
ー 9 新大阪 M テビル 1 号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

添付公開書類:

— 國際調查報告（條約第 21 條(3)）

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC-COMPONENT DEVICE

(54) 発明の名称：電子部品装置の製造方法



(57) Abstract: A method for manufacturing an electronic-component device, said method having the following steps: step A, in which a laminate comprising an electronic component mounted on a mounting body is prepared; step B, in which a sealing sheet is prepared; step C, in which said sealing sheet is placed on top of a heating plate and the laminate is placed on top of the sealing sheet with the surface of the laminate on which the electronic component is mounted facing down; and step D, in which, after step C, hot pressing is used to embed the electronic component in the sealing sheet.

(57) 要約: 電子部品が被実装体に実装された積層体を準備する工程Aと、封止用シートを準備する工程Bと、加熱板上に封止用シートを配置するとともに、封止用シート上に積層体を電子部品が実装された面を下にして配置する工程Cと、工程Cの後、熱プレスして、電子部品を封止用シートに埋め込む工程Dとを具備する電子部品装置の製造方法。

WO 2014/18882 A1